2026 年 11 月 27 日

報道関係者　各位

会社名　　レーザーテック株式会社
代表者名　代表取締役社長執行役員 仙洞田 哲也
（コード：6920　東証プライム市場）
問合せ先　執行役員 横川 久
（TEL.045-478-7111）

新製品 EUV 露光プロセス向けウェハ裏面異物検査装置 DHIOS シリーズ「BS300」を発表

【概　要】

この度、レーザーテックはウェハ裏面異物検査装置 DHIOS シリーズ「BS300」を製品化いたしました。本製品は、従来のウェハ裏面異物検査装置にはなかった「高さ情報」を新たな検査指標として採用し、微小異物の高感度検出と高さ情報の取得を同時かつ高速に行うことを実現した新しいコンセプトの検査装置です。

先端露光プロセスにおけるデフォーカスエラー（焦点ずれ誤差）やオーバーレイエラー（位置ずれ）の原因となり得る、高さを有する異物を効率的に検出することで、露光精度の向上に貢献します。

【内　容】

ウェハ裏面とステージまたはチャックとの間に高さを有する異物が存在すると、ウェハ表面に局所的な高さ変化が生じ、EUV 露光プロセスにおけるデフォーカスエラーやオーバーレイエラーを引き起こす要因となります。

一方、従来のウェハ裏面光学式検査では、検出された散乱光の強度から異物サイズは判定できるものの、高さ情報の取得が難しく、露光プロセスに影響する異物の判別が課題となっていました。

「BS300」は、レーザーテック独自の光学技術により、異物の検出と高さ情報の取得を同時かつ高速に行うことを実現しました。これにより、微小異物を高感度に検出しながら、デフォーカスエラーやオーバーレイエラーの原因となり得る高さをもつ異物を効率的に抽出できます。

当社は今後も、先端半導体プロセスにおける検査ニーズに応えるソリューションを提供し、半導体製造工程の品質改善と歩留まり向上に貢献してまいります。

【特　長】

- デフォーカスエラーの原因となり得るウェハ裏面の異物を検出
- 異物検出と高さ情報の同時取得を実現
- ウェハ表面の異物高さ検査にも適用可能

【用　途】

- EUV 露光プロセスにおける裏面の異物管理



ウェハ裏面異物検査装置 DHIOS シリーズ「BS300」

お問い合わせ先
〒222-8552 横浜市港北区新横浜 2-10-1
レーザーテック株式会社　第 1 ソリューションセールス部　戸田　愛梨
TEL：045-478-7337
E-mail：sales@lasertec.co.jp